

## 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 19 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。上述议案在董事会审议的权限范围内，无需提交股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

### 一、授信情况概述

为满足业务发展需要，公司拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请一年期综合授信额度最高不超过人民币 18,750.00 万元（含人民币 18,750.00 万元）、拟向富邦华一银行有限公司上海临港新片区支行申请一年期综合授信额度最高不超过人民币 10,000.00 万元（含人民币 10,000.00 万元），用于办理各类融资业务，包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金贷款、保理 e 融、商业承兑汇票贴现等综合业务。上述授信额度均为纯信用无担保方式，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

公司董事会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件。

### 二、本次交易目的和对公司的影响

公司向相关商业银行申请授信额度，是基于公司 2025 年度的实际业务发展需要，有利于缓解公司的资金压力，有利于公司业务的开展，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不存在违反相关法律、法规的情形。

### 三、备查文件

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025年6月19日